

Ящеріцин Е.В., Терлецький О.С., Україна, Харків

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР ШКМ Cu – Та ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

У доповіді наведено експериментальні характеристики концентраційної залежності питомого електричного опору ШКМ Cu - Та. Подано трактування отриманих результатів, яке включає адитивний вплив на електропровідність композита Cu - Та його компонентів - Cu, Та, Ni та дифузійного шару (Cu + Ni).

Ящерицын Е.В., Терлецкий А.С., Украина, Харьков

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКМ Cu – Та ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

В докладе представлены экспериментальные данные по концентрационной зависимости удельного электрического сопротивления СКМ Cu - Та. Приведена трактовка полученных результатов, которая включает аддитивное влияние на электропроводность композита Cu - Та его компонентов - Cu, Та, Ni и диффузационной зоны (Cu + Ni).

Yasheritsin E.V., Terletsky A.S., Ukraine, Kharkov

ELECTRIC RESISTANCE MICROLAYER COMPOSITE Cu – Та BY ROOM TEMPERATURE

In the report describes experimental statistics on concentration dependence specific electric resistance microlayer composite Cu - Та. The interpret presents received results that including additive influence on electrical contacting composite Cu - Та this components - Cu, Ta, Ni and diffusion zones (Cu + Ni) is resulted.